

株式会社ピクリング



自動車・鉄道・船舶

家電・エレクトロニクス

医療・介護福祉・健康

半導体製造装置に限らず、開発から製造まで独自のシステムで他社の手掛けない特殊（製造）装置のパイオニアと評されております。



モジュール組立機



チップ外観検査装置



厚さ測定機（レーザセンサ/エアースensa）

得意技術

- ・搬送系：多種多様の高精度ロボットを使用した搬送系を提供
- ・制御・ソフト：ソフト設計、開発等
- ・検査・測定：多種・多品ワークの厚さ自動測定・検査機等
- ・溶着・加工：超音波による溶着技術等

主要事業・主要製品

半導体製造装置部門：エアスキャナーによる非接触厚さ測定機、薬液塗布装置、ウエハー移載機、モジュール組立機、チップ外観検査装置、自動ねじ締・ねじ外し装置、暗電流測定器
 メタルボンディング装置、各設備との自動・省力化
 半導体以外：タップ検査装置（ナットのバリ等外観画像検査選別）、自動コゲ取り装置（溶接後汚れ等除去）

得意な顧客・市場分野

半導体・液晶・自動車関連分野

今後の展開について

「小さな世界企業」を目指します。小さな、はスモールではなくローカルでありニッチ。
 受け継いだものを引き継ぎ、更にイノベーションとなりうる製品を求めています。

働きやすい・働きがいのある職場づくり

従業員的能力を磨きかけトレーニングする少数精鋭の企業です。
 経験豊富な技術者が若手に高度な技術を丁寧に継承し、一人前の技術者に育て上げます。
 若手とベテランが融合し、行政に置き換えると行政改革が進んだ企業であり、人を大切にする企業です。

グローバルビジネス

まずは日本のローカルである地元地域で足固めをしていきます。

主要設備・研究体制

クリーンルーム（床面積：100㎡、クリーン度：クラス1000）、研究体制は今後大学、同業社、異業種等関わりを持つ機会を得たい。

主要取引先

キヤノン(株)、セイコーエプソン(株)、東芝プラントシステム(株)、ハイソル(株)、(株)日立パワーデバイス、富士電機パワーコンダクタ(株)、富士電機(株)松本工場、超音波工業(株)、兼松 PWS (株)、新電元工業(株)、(株)京都セミコンダクター、テスコ(株)

取引先金融機関

川崎信用金庫、みずほ銀行

名称	カブシキガイシャピクリング 株式会社ピクリング	代表者	小野 猛	担当窓口	滝澤 孝徳	資本金	1,000万円	従業員数	12名
所在地	〒223-0057 横浜市港北区新羽町925			TEL	045-633-7377	FAX	045-633-7378		
HP	http://www.picring.co.jp			E-mail	ttakizawa@picring.co.jp				

設計・製作・製品

金型・治工具

機械要素・部品

工業用装置機器等

ロボット・ドローン

次世代交通システム

電気・電子機器等

通信・監視・計測・分析等

主業務が設計・開発（ファブレス的）